有限要素法による異種の構造から導入される重畳応力の評価

Stress superposition from Heterogeneous Origins Evaluated by Finite Element Method Simulation

明治大理1、学振特別研究員 DC^2

^O富田 基裕^{1,2}、小瀬村 大亮¹、小椋 厚志¹

Meiji Univ.¹, JSPS Research Fellow DC²,

[°]Motohiro Tomita^{1, 2}, Daisuke Kosemura¹, and Atsushi Ogura¹

E-mail: mot_tom@meiji.ac.jp

【はじめに】 歪 Si はポストスケーリング技術 における次世代材料の一つであり、次世代トラ ンジスタへの応用が期待されている。埋め込み SiGe (eSiGe)および SiN 応力膜は既に最新の MOSFET に適用されている[1,2]。しかし、ナ ノスケールのチャネル領域に導入される応力 は、様々な構造起因の応力が重畳されるため複 雑化することが予想される。本研究では、有限 要素法(FEM)を用いて、eSiGe 層と SiN 膜を有 する試料に導入される重畳応力を評価した。

【実験】 試料はSiに厚さ100 nmのeSiGeおよび、 膜厚50 nmのSiNを持つ基板をモデルとした。 Fig. 1に本研究で用いた試料構造を示す。x方向 Siチャネル長さは1000, 500, 200, 100, 50, and 30 nmであり、y方向チャネル幅は無限を仮定した。 FEMでは約10,000~12,000の四角形一次要素を 用いた平面歪モデルにより計算を行った。

【結果】Fig. 2 にチャネル長 100 および 50 nm の構造における表面下 10 nm の x 方向 1 次元 σ_{xx} 応力分布を示す。SiN により導入される応力分 布は SiN のエッジ部分で最も強く、チャネルに 導入される応力はチャネル長 100, 50 nm の構 造において約–0.8, –1.0 GPa である。対して、 eSiGe では x = 100, 50 nm の構造においてチャ ネル中央で最も応力が強い。チャネル中央での 応力は–2.6, –2.8 GPa である。また、eSiGe と SiN が組み合わさった時に導入されるチャネ ル応力は–3.3, –2.8 GPa である。Fig. 2 下段に示 した eSiGe と SiN の構造を別々に FEM 計算し た結果を足しあわせた応力分布と eSiGe と SiN の両方を持つモデルを FEM 計算した結果はほ ぼ一致している。

Fig. 3 にチャネル長 1000~30 nm の構造にお ける表面下 10 nm の σ_{xx} チャネル平均応力のチ ャネル長(X)依存性を示す。FEM により得られ たチャネル長は、過去の研究結果と同様の傾向 を示している[1,2]。また、本実験で行ったすべ てのチャネル長において eSiGe と SiN の組み合 わせから導入される応力は、別々に計算した結 果の足しあわせで再現できている。今後、足し あわせで表現できない非線形な条件の有無を 確認し、その原因の検証を行う予定である。 本研究の一部は、(株)半導体理工学研究セン ター(STARC)および日本学術振興会の特別研 究員奨励費(24・10247)により助成を受けたも のである。

[1] M. Takei et al., J. Appl. Phys. 107, 124507 (2010).

[2] S. Mayuzumi *et al.*, IEEE Trans. Electron Devices **56**, 2778 (2009).



Fig. 3 X length dependence of averaged σ_{xx} in the samples on channel lengths from 1000 to 30 nm.